



Systemdatenblatt

TC FLOOR WDD AS

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10 % Wasser

*** Bedarfspositionen

- **Egalisieren mit einem gefüllten, wässrigen, zweikomponentigen Epoxydharzspachtel**
mind. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>
ca. 0,5 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF <6751> sowie 0,05 l Wasser (bis 10% bez. auf Bindemittel)
- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**
ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel**
mind. 0,150 kg/m² Remmers Conductive LE <6701>
- **Versiegelung mit einem elektrostatisch leitfähigen, wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
0,20 - 0,30 kg/m² Epoxy BS 3000 AS (Farbton nach Wahl bzw. Anfrage des AG)<6394>